

拓荆科技股份有限公司投资者关系活动记录表

股票名称：拓荆科技

股票代码：688072

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(电话交流、反路演、策略会等形式)
参与单位名称	易方达基金、东方基金、银华基金、华西证券、民生证券、国联基金、华创证券、泰康保险、东方红资产管理、摩根大通基金、招商基金、汇添富基金、浦银安盛、兴全基金、国泰基金、华安基金、中银基金、富国基金、安信证券、财通证券、睿远基金、永赢基金、诺德基金、盘京投资、天弘基金、华富基金、博时基金、长城基金、交银基金、德邦基金、国泰君安证券、华商基金、和谐汇一资产管理、国盛证券、创金合信、信泰人寿、人保养老、南方基金、3W Fund Management、Millennium Capital、东兴基金、东吴基金、东方资管、东方阿尔法、东证资管、东财基金、中信保诚人寿保险、中信建投证券、中信证券、中欧瑞博基金、中欧基金、中邮基金、丰源正鑫投资、于翼资产、中邮证券、光大证券、山西证券、亚太财险、保银基金、信德基金、信达澳亚基金、元贞铭至基金、光大资管、兴业银行、兴证全球基金、创富兆业基金、创汇投资、创金合信基金、前海联合基金、华泰柏瑞、华美国际、南方天辰、博远基金、君弘投资、嘉合基金、国君资管、国寿安保、国金基金、大家资产、大成基金、天倚道投资、天安人寿、太平洋资管、宁泉资产、安徽铁路基金、宏利基金、宝盈基金、富荣基金、山楂树基金、川发展基金、平安基金、广发基金、广发资管、建信养老、恒大人寿、恒安标准人寿、惠升基金、惠理基金、招商资管、招银理财、摩根士丹利基金、敦和资产、新华基金、方正富邦基金、旌安投资、景林资产、景顺长城基金、智诚海威资管、望正资产、朱雀基金、杭银理财、正心谷基金、中再资产、海富通基金、立格基金、Eastspring Investments Funds、贝莱德基金、润晖基金、路博迈基金、海通证券、百年保险资管、毅恒资本、泓德基金、国投证券、Greenwoods Asset Management、Fullerton Fund Management、Comgest Asset Management、T. Rowe Price、APS Ethical Fund、Pictet Asset Management 等
时间	2024年3月1日至2024年3月29日
地点	沈阳、上海、无锡、广州、深圳等现场会议、电话会议、网络会议
公司接待人员姓名	董事长：吕光泉 董事会秘书：赵曦 证券事务代表：刘锡婷

投资者关系活动主要内容介绍

问答环节主要内容:

1. 公司战略发展规划及未来展望是什么? 是否会向平台化公司转型?

答: 公司主要聚焦在高端半导体设备领域, 目前已经推出了以 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 等为主的薄膜系列设备产品, 以及应用于晶圆级三维集成领域的混合键合设备产品。未来公司将继续在 CVD 领域深耕, 不断提升产品性能, 保持产品核心竞争力, 进一步提升市场应用规模。同时, 公司将积极推进混合键合设备的研发和产业化, 扩大潜在市场的应用。目前公司暂无计划向平台化公司转型, 公司力争通过专精深的专业技术在 CVD 以及混合键合领域快速发展, 进而为投资者带来回报。

2. 公司 2023 年产品订单情况及结构如何?

答: 截至 2023 年 12 月 31 日, 公司在手销售订单金额超过 64 亿元 (不含 Demo 订单), 目前在手订单充足。公司 2023 年新签产品订单中以 PECVD 产品订单为主, ALD、SACVD、HDPCVD 等产品订单量亦在不断提升, 公司 2023 年新签产品订单主要来自存储芯片、逻辑芯片等集成电路领域, 存储芯片及逻辑芯片领域订单约各占一半。

3. 公司目前 PECVD、ALD 等产品的工艺覆盖率情况? 以及在公司客户端的进展情况?

答: 公司持续保持高强度研发投入, 目前 PECVD 产品可以实现全系列 PECVD 薄膜材料覆盖, 包括通用介质薄膜 (SiO_2 、 SiN 、TEOS、 SiON 、 SiOC 、FSG、BPSG、PSG 等) 及先进介质薄膜 (LoKI、LoKII、ACHM、ADCI、HTN、a-Si、ONO 等); 公司研制的 PE-ALD 设备已经实现量产, 可以沉积 SiO_2 、 SiN 等介质薄膜材料; Thermal-ALD 设备已经出货至不同客户端进行验证, 可以沉积 Al_2O_3 等金属及金属化合物薄膜。公司持续扩大 PECVD、ALD 等产品的工艺覆盖面, 并根据客户需求持续创新、提升性能指标, 公司薄膜设备产品已获得客户的大量订单。

4. 公司产品交付周期、验证周期和确认收入的节奏情况?

答: 根据产品配置不同、客户需求节奏不同, 订单交付时间不同。公司产品从签订订单到交付的平均周期通常为 3-6 个月。因为薄膜沉积设备所沉积的薄膜是芯片结构的功能材料层, 在芯片完成制造、封测等工序后一般会留存在芯片中, 薄膜的技术参数直接影响芯片性能, 所以, 薄膜沉积设备在晶圆厂产线上所需要的验证时间一般较长 (验证平均周期 3-24 个月)。公司产品在客户验证通过后拿到交付验收单, 才能确认收入。

5. 公司如何预期半导体设备行业 2024、2025 年市场情况?

答：根据 SEMI 预测，经过 2023 年的调整，2024 年、2025 年全球半导体设备市场规模有望迎来复苏，预计 2025 年全球半导体制造设备的销售额增长至 1240 亿美元。终端产品增量会拉动产业需求，进而拉动上游设备的需求量。公司积极跟进下游客户需求，加快机台迭代优化及订单导入速度，不断提升市场占有率。

6. 公司如何看待目前国内竞争格局？

答：半导体设备具有技术壁垒高、研发投入高、技术更新迭代快等特点，一般从设备的研发、送至客户端验证、在客户端生产线应用及量产，通常需要较长周期。拓荆科技已在半导体薄膜设备领域深耕十余年，自主研发的 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 等系列薄膜设备均已实现量产，且公司设备在客户端产线生产运行稳定性表现优异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司在客户端累计生产的流片量超过 1.5 亿片，2023 年度平均机台稳定运行时间（Uptime）超过 90%（达到国际同类设备水平），公司产品在客户端的量产指标表现可以体现公司产品的竞争实力及量产能力。在设备产品从研发推向产业化过程中积累了丰富的经验，且公司薄膜沉积设备导入集成电路领域市场并实现产业化的时间较早，现已经形成了研发团队、技术储备、客户资源及售后服务等方面的优势，并在推进产品创新方面具有扎实的技术基础，可以及时满足客户需求。未来公司将持续保持高强度研发投入，持续提升产品性能，保持产品核心竞争力及市场领先地位。

7. 公司混合键合设备的进展情况？未来主要可以用于哪些应用领域？

答：公司晶圆对晶圆键合产品（Dione 300）、芯片对晶圆键合表面预处理产品（Pollux）均已通过客户验收。混合键合设备主要应用于三维集成领域，覆盖存储/逻辑芯片、先进封装、图像传感器等细分领域，未来潜在市场空间较大。

8. 公司是否有计划拓展海外市场，目前进展情况如何？

答：公司有计划拓展海外市场，并一直在寻找合适的机会。2023 年，公司已出货一台设备至海外市场，后续将继续积极推进海外市场的规划布局。

9. 公司目前整体的人员规模及产能布局？是否可以满足目前公司需求？

答：公司目前人员规模达到 1000 余人，在沈阳总部、上海临港（一厂和二厂）、海宁均有研发与生产基地，目前人员团队和产能均可以满足当前公司的研发、生产需求。